

### "材料人"系列讲座——第三讲 2017年11月5日





1.灯丝损坏及安装 2.灯丝饱和点及电子束合轴 3. 像散 4.加速电压 5. 束流 6.亮度和对比度 7.调焦 8.成像时的一些参数 9.操作步骤

目录



发夹形钨阴极、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Ir阴极、LaB<sub>6</sub>阴极、场发射阴极

	发夹形钨丝	LaB <sub>6</sub>	冷场	热场
亮度(A/cm <sup>2</sup> ·sr)	10 <sup>5</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>8</sup> ~10 <sup>9</sup>	5×10 <sup>8</sup>
光源交叉斑(µm)	20~40	7~15	0.01~0.02	0.02~0.04
工作温度(K)	2650~2750	1750~1850	~300	1750~1850
灯丝烧洗	否	否	是	否
使用寿命(h)	~100	~1000	≥10000	≥10000
真空度(Pa)	~10 <sup>-3</sup>	10 <sup>-4</sup> ~10 <sup>-5</sup>	<10 <sup>-7</sup>	<10-6
抗干扰能力	很强	较强	差	一般
高分辨电镜适用性	不能用	可用	很好	很好

 東斑大
 東斑较小
 東斑校小
 東斑泉小

 東流密度软小
 東流密度最大
 東斑小

## 1.灯丝损坏及安装---灯丝损坏

灯丝损坏的原因:

(1) 热发射需要较高的灯丝温度,灯丝蒸发速率随温度成指数提高,因此在满足使用条件下,尽量使用较低灯丝温度,这有利于增加灯丝的寿命,这就要求实验室的空调需调制制冷状态。

(2) <u>真空泄露</u>会使真空度低,这易在钨灯丝表面容易形成氧化钨层, 而氧化钨的蒸发速度比单质钨要大,灯丝寿命明显缩短,因此在试验 操作过程中,应保持样品腔真空状态。

(3) 空气湿度大,水蒸气含量高,形成的水循环效应会大大减小钨 灯丝寿命,因此在试验过程中应保持实验室湿度。

(4) 灯丝加热电流加载过快,造成热应力损伤。因此电流、电压、 束流Iprobe应控制较低范围内。

(5) 在适当的时间内我们可提高拍摄进程,加快测试速度,这也有利于钨灯丝电子枪的使用寿命。

(6)长时间使用高倍拍摄,会对电子枪造成不利影响,使其使用寿 命下降,所以当需要高倍拍摄时需要实验一段时间后关闭电子枪冷却。

1.灯丝损坏及安装---灯丝安装

### 1.1 更换新灯丝



### 1.2 清洗部件

用抛光膏清洁固定盘表面、栅极帽内孔的黑斑,直到露出金属光泽,酒精超声清洗这两件,在放大镜下确保内孔没有残留物

#### 1.3 安装部件

注意灯丝脚与固定盘上的两个槽口对 齐,调节四个螺钉使陶瓷座与固定盘 内孔同心,调好后,拧紧四个螺钉, 见左图所示。

将上述组件放入对中圈内,调整另一组 四个螺钉,使灯丝组件与对中圈同心。 调好后,拧紧四个螺钉。注意固定盘上 的缺口和小孔要与对中圈上的销和槽对 齐。

将弹簧片放入栅极帽内,再放入上述组件, 利用调节圈锁紧,见左图。将组件翻转, 使栅极帽内孔向上,观察钨尖是否在孔中 心,可以重复上述调整步骤,使钨尖位于 孔中心,最好在体视显微镜下调整,转动 栅极帽,从两个方向判断钨尖是否调整到 孔心。







手持整个组件,转动调节圈,使钨尖与栅极帽大平面同高。反时针转动调节圈1圈加1/4圈,钨尖缩入下表面0.6mm,见下图。每次更换灯丝均要保证这个缩入量。也可以反转3/4圈,增加灯丝发射束流,分辨率可适当改善,但灯丝寿命可能略短。





## 2.灯丝饱和点及电子束合轴

当观察上千倍图像时,如果反复调焦发现图像跑动,说明物镜光阑不合 轴,利用物镜光阑调节钮合轴。像散调节效果不明显。 : 高倍二次电子成像漂移明显、高倍能谱漂移明显、低倍也存在。



×10000

✓ 电子枪合轴
✓ 物镜光阑合轴
✓ 像散

**2.**灯丝饱和点及电子束合轴——2.1饱和点



灯丝电流的调整直接影响灯丝寿命 及发射电流强度,电子枪亮度随灯 丝温度上升而增加,但当电子枪亮 度增大一定程度后,再增加灯丝电流, 则亮度增加较少,即灯丝电流饱和,

超过饱和点后,灯丝电流继续增加不仅对电子枪亮度贡献不大,反而影响<mark>灯丝 寿命</mark>。灯丝使用一段时间后,产生应力变形及热蒸发,灯丝顶端相对栅极偏移, 需要检查饱和点及合轴情况。



手动:在有图像时,选择发(Emission), 黑屏上出现黄色米字线,交叉点为屏幕中 心,在中心附近出现一个椭圆亮斑。如果 灯丝处于第1峰位附近,中间小亮斑外围 有较暗的大亮斑,此亮斑会在第2峰位饱 和点时逐步缩小并和中间小亮斑聚合。先 利用Gun Shift调节大亮斑在正中,再调节 Gun Tilt使小亮斑在正中。而后选择正常 (Normal),高亮度图形复出。

### 灯丝像椭圆;大小亮斑不聚合; 及移动到极限位置依然无法调灯丝像;



注: 钨灯 丝通常椭 圆灯丝像, 场发射通 常圆形。

# 2.灯丝饱和点及电子束合轴——2.2合轴





Y调节钮

X调节钮

用震动(Wobble)功能,图像发生不规则跑动,分别 仔细调节X和Y两个旋钮,使图像不跑动,只是如同呼 吸一样原地闪动,这时光阑合轴调好了,关闭震动功能。 调高倍率图像时,在电子枪合轴后,物镜光阑必须合轴, 才能消像散。

检验:图像在调焦时,图像不会明显移位或者漂移,即合轴良好



产生像散: 电子学系统中所形成的磁场及静电场不能满足轴对称的要求。磁场 不对称而造成的像散对一台确定的仪器是固定不变的,静电场引起的像散主要 是电子通道周围被污染,特别是物镜光阑被污染时将严重产生像散。

像散特征:在过焦和欠焦时图像细节互为90°方向拉长; 像散校正:通过调整消像散器,利用调焦功能键辅助; 注:像散特别严重时应考虑清洗镜筒和物镜光阑。

3. 像散

消像散图
正焦
过焦
欠焦



当观察高倍图像时,反复调焦都不清楚,图像在相互垂直方向上有模 糊边,见上图,这就是像散,必须予以消除。

点击消像散图标 调焦,清晰度 (Stigmation), 有所改善, 该 拖动鼠标左键分 过程反复进行, 别上下或左右移 直到图像清晰 动, 使模糊边 尽量减小,

点击消像散 (Stigmation), 分别拖动XY坐标 线的两个方向滑 尺,减少模糊量

利用手动操作板 上的两个消像散 旋钮,分别缓慢 转动,消除模糊 边

▶ 提高极靴的加工精度:減少像散途径 均匀性好、结构致密、无气孔的软铁或其他铁磁性材料作极靴。

▶ 提高光阑的加工精度: 良好的旋转对称性和锋利整齐的边缘、保证边缘清洁、及时更换。

▶ 调整消像散器:

装配精度高、减少及尽量消除像散,一般只能消除低频像散。

▶ 电子光学通道洁净:

碳氢聚合物沉积形成有机膜层,负电荷难以排出,影响入射电子束的原定路线,电子束斑呈不完全旋转对称。

注:随工作距离增加,即焦距加大,像散增大; 如果内部被污染,在改变加速电压的时候,须重新进行像散校正 5000倍及以下图片质量不能被接受,需要对电镜进行清洗

# 加速电压是重要参数, 仪器提供的使用范围0.2~30kV, 需要根据样品种类和分析目的进行选择, 见下:

4.加速电压

样品成像或成分分析	加速电压 (EHT/kV)	应用
低原子序数样品	5~10	纤维、塑料、橡胶、食材等
中等以上原子序数样品	10~20	金属、半导体、陶瓷,常规观察
高分辨率观察	20~30	电子束波长短,像差小,高倍
荷电样品	1~3	不导电样品
能谱分析	15~20	与元素种类有关



能谱分析中,选择加速电压通常需要考虑如下因素: 1,加速电压必须大于被测元素线系的临界激发能。比如:NiK线的临界激发能为7.47kV,加速电压通常为其2-3倍,即 15-20kV较合适。2,需要有合适的过压比。如此可使试样中产生的X-ray有较高的强度, 较高的峰背比。实验表明,过压比约为2.5倍时,X-ray强度最高。而过压比大于1时, 才能激发出该特征x-ray。为了有效激发获得高峰值强度,过压比至少等于2。 电子枪发射束流,经过聚光镜调节,会聚成更小的束斑尺寸(Spot Size) 入射样品,其对应的束流称为探针电流(lprobe),探针电流大,束斑 尺寸相应增加,见下表,探针电流从5pA变到100pA,束斑尺寸明显变大。 而后,束斑尺寸随探针电流变大趋于平缓,两者不呈线性关系。



5. 束流

	探针电流(pA)	東斑尺寸
高分辨像	1~5	120~220
常规观察	>20	>300
背散射像	100~300	390~450
X射线成分分析	300~600	450~490
荷电样品	3~5	160~220

小束流

min

大束流



6 亮度和对比度

亮度: 指图像的基准电平。也就是当没有图像时屏幕的亮度。 对比度: 指对形成图像信号的放大量。 灰度: 指黑白之间能够分辨的等级数。

增大对比度,降低亮度可以使图像的立体感增强

由于二次电子衬度原理,边缘效应,样品导电性等条件影响,图像有时反差过大,表现为有的地方特别亮,有的地方特别暗。

调节灯丝像:亮度和对比度47%左右,电压15~20,束流80~100; SE局部特别亮时:降低对比度,适当增加亮度; SE全部特别暗时:适当增加对比度和亮度,先增加亮度; BSD衬度不明显时:增加对比度、增大束流(IProbe); 能谱计数低:增大束流、增大电压; 扫描速度与图片衬度的关系:

注:

- □ 当扫描速度越大时,形貌衬度越不明显,边沿效应越小,反之速度 越小,边沿效应越明显。
- □ 建议在低倍寻找需要区域时,速度快,节省时间;
- 在中高倍寻找区域或中低倍拍摄照片时,速度稍快,保证移动时图 像清晰又能节约时间;
- □ 在中高倍拍摄样品时,速度慢,保证图片清晰度。

当高倍下扫描时,需要速度较慢,此时若出现边沿效应明显,需要降低对比度,并适当调整亮度,以求得到满意的图片质量。





如果需要景深增大:欠焦或过焦;增大工作距离



### SED/BSD成像

常规观察 高压EHT=10~20kV 束流l probe=20~200pA 工作距离WD=10~15mm 灯丝电流l第一峰位 <10kx 灯丝电流l第二峰位 >10kx 物镜光阑 30μm 成像扫描时间 20s 高分辨观察 高压EHT=30kV 束流l probe=3~10pA 工作距离WD=5mm 灯丝电流l第二峰位 >10kx 物镜光阑 20μm 成像扫描时间 80s

常规观察选EHT=10kV, lprobe=20pA, 样品微区的表面细节优于20kV。

成分像操作条件的选择与形貌像常规观察类似,但必需选用背散射电子探测器(BSD), EHT=15~20kV, lprobe=100~200pA。

## 8 成像时的一些参数

可变压力(Variable Vacuum,简称VP)成像

对于荷电效应明显的样品,利用可变压力功能(VP模式),范围 10~400Pa,可以直接观察这类样品,样品室通入适量气体,这些气 体被电子束电离,正离子与样品表面负电荷中和,消除荷电效应。

选用这种模式时,样品室的真空比镜筒真空差,要求在物镜下部安装限压光阑(Pressure Limiting Aperture,简称PLA),将样品室和镜筒隔开,以保证电子枪与镜筒仍然处于高真空下。



操作步骤:

a)将750µm物镜光阑推入光轴,需马上合轴 调整。在VP下,Wobble功能不起作用。
b)样品室放气,取下BSD,放到储存位。
c)利用专用工具安装100µm光阑,见左图,不要拧的过紧。将BSD复位。
d)选中Select Aperture,VP功能激活,选择 所需的VP值,例如10Pa,抽真空。

e) 选用探测器BSD或VPSED, SED不能使用。

高真空操作

高压EHT=1kV 束流l probe=10pA 工作距离WD=5mm 灯丝电流l第二峰位 物镜光阑 30μm 成像扫描时间 20s EHT可以按100eV的间隔调整, 直到消除荷电效应 VP操作

高压EHT=25kV 東流I probe=250pA 工作距离WD=8.5mm 灯丝电流I第二峰位 物镜光阑 750µm, PLA=100µm 成像扫描时间 20s或更长 样品室压力: 10Pa用BSD, 40Pa用VPSED 以消除荷电为准

## 8 成像时的一些参数

扩展压力(Extended Pressure,简称EP)成像

对于含水样品,样品室可以通入适量水蒸气,延缓冷冻样品中水分的挥发,或者使水分基本不挥发,样品保持原生态观察

对于含水样品的直接观察,在PLA基础上还要加装500µm电子束套筒 (Beam Sleeve),保持电子束在较高的真空下达到样品表面,特别有利 于能谱分析和改善分辨率。最好配有样品冷冻台,样品中的水分结冰固定 后,采用EP模式,压力选在2000Pa,样品中水分挥发少,所含元素不会 走动,也适合微区成分分析。

EP模式操作(冷冻样品) **EP**模式操作(含水样品) 高压EHT=30kV 高压EHT=30kV 束流I probe=300pA 束流I probe=300pA 工作距离WD=8.5mm 工作距离WD<5mm 灯丝电流I第二峰位 灯丝电流I第二峰位 物镜光阑 750µm PLA=100µm 物镜光阑 750µm PLA=100µm 电子束套筒500µm 成像扫描时间 20s或更长 样品室压力: 650Pa, 缓慢脱水, 温度保持1℃ 成像扫描时间 20s或更长 样品室压力: 2000Pa, 样品保持20℃

## 9 操作步骤——9.1开机

在电镜基座的前面板上有绿(ON)、黄(STANDBY)、红(OFF)三个按钮



- 接通电源后,按红色按钮,电镜通电。
- 按黄钮,真空系统开始工作,整机处于待机状态。
- 约1分钟后按绿钮,所有系统开始工作,同时电脑自动启动(或人工手动启动),进入系统。
- 双击 SmartSEM 并登陆









9操作步骤——9.2观察样品

	(EHT/kV)	
低原子序数样品	5~10	纤维、塑料、橡胶、食材等
中等以上原子序数样品	10~20	金属、半导体、陶瓷,常规观察
高分辨率观察	20~30	电子束波长短,像差小,高倍
荷电样品	1~3	不导电样品
能谱分析	15~20	与元素种类有关



□ 选择合适光阑,如图为 SEM Control: Aperture 面板: Aperture size 的下选择光阑(-般 30µm 光阑即可,采集能谱信号需要 60µm 或 120µm 的大光阑);光阑选择后勾上 Focus Wobble,Wobble amplitude 调整为 50%左右;选择 Aperture Align 中调节光 阑,调至图像不再跑动,原地闪动即可;再勾掉 Focus Wobbe(在放大倍数不是很大 情况下,wobble 可以不用调节,若放大倍数一万倍以上,wobbble 必须需要调节)。







## 9 操作步骤——9.3 高质量图片的获取

找到感兴趣的区域后,低倍下聚焦,消像散,调节光阑对中;提高放大倍数, 再聚焦,消像散。如此类推,直至需要的放大倍数。以下为消像散的方法: a1 点击下拉菜单的消像散图标,拖动鼠标左键分别上下或左右移动,使模糊 边尽量减小,再调焦,清晰度有所改善,该过程反复进行,直到图像清晰。 a2 在光阑版面点击消像散(Stigmation),分别拖动 XY 坐标线的两个方向 滑尺,减小模糊量。

a3 利用手动操作板上的两个消像散旋钮,分别缓慢转动,消除模糊边。



选择合适的 Scan Speed、Store resolution 和 Noise Reduction, 使去除噪音 的效果最好,得到高质量的图片。一般选择扫描速度为"6"。噪声去除方式选择 线平均: line avg,积分次数选"N=30 左右"即可。 然后点击 Freeze 键 (注意 Freeze 的模式选择 End frame) 。

保存:光盘、联网传输





## 谢谢收听,如有不妥,敬请指出 邮箱: 1412365584@qq.com

注:本ppt借助ZEISS 培训资料

